



Deklaracja Zgodności CE

PL1 Przenośna pętla indukcyjna

Oznaczenie i opis produktów:

- PL1/K1 Przenośna Pętla Indukcyjna 1,2m²
- PL1/K3 Przenośna Pętla Indukcyjna 1,2m²

Produkowane przez C-TEC w:

Computationics Ltd (Trading as C-TEC), Challenge Way, Martland Park
Wigan, WN5 OLD, Wielka Brytania

są zgodne z postanowieniami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- 2014/30/EU: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)
- 2014/35/EU: Dyrektywa Niskiego Napięcia (LVD)
- 2011/65/EU: Dyrektywa w Sprawie Ograniczenia Stosowania Niektórych Niebezpiecznych Substancji w Sprzęcie Elektrycznym i Elektrycznym (RoHS)

Produkty objęte deklaracją zostały zbadane i spełniają wymagania następujących norm:

- EN 55103-2: 2009 Kompatybilność elektromagnetyczna. Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym. Odporność
- EN 55103-1: 2009+A1: 2012 Kompatybilność elektromagnetyczna. Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym. Emisje
- EN 60065: 2014 Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa (zastąpiona przez BS EN 62368-1:2014)
- EN50581: 2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Dodatkowo, poprawnie zainstalowany produkt spełnia główne wymagania następujących norm:

- BS 7594: 2011 Kodeks postępowania dla układów pętli indukcyjnych (A FILS)
- BS EN 60118-4: 2015 Elektroakustyka. Aparaty słuchowe. Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – Wymagania dotyczące parametrów układu.

Osoba upoważniona do składania podpisów w imieniu Firmy

Ja, niżej odpisany, niniejszym oświadczam w imieniu Computationics Limited, że produkty wymienione powyżej są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionych norm, co jednocześnie oznacza zgodność z głównymi wymaganiami wyżej wymienionych dyrektyw.

Imię i Nazwisko: Stephen A. Stringfellow

Stanowisko: Dyrektor Działu R&D

Podpis:

Data: 16.8.16